关于梅州市铜箔-高端印制电路板产业集群发展规划（2021-2025年）执行情况报告

“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是梅州市铜箔-高端印制电路板产业转型升级发展的重要阶段，2021年1月梅州市印发《梅州市铜箔-高端印制电路板产业集群发展规划（2021-2025年）》（以下简称《发展规划》），力争梅州市铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）集群到2025年整体规模实现发展。本报告旨在对梅州市铜箔-高端印制电路板产业集群发展规划执行情况进行评估，并根据实际情况提出调整目标，为产业的发展提供科学依据。

一、规划执行情况回顾

（一）产业规模方面

按照《发展规划》，铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）集群包括铜箔、覆铜板、电路板、电声、家电、手机、电脑、平板等终端产品产业，到2025年末，产业集群产值规模力争达到600亿元。依据统计数据，2021年至2024年，全市铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）集群规模以上企业总产值分别为189.9亿元、202.98亿元、237.11亿元、248.26亿元，增速分别为6.89%、34.13%、4.7%；三年平均增速约6.9%。因此就全市而言，铜箔-高端印制电路板产业（新一代电子信息产业）规模在规划执行期间呈现出一定的增长态势。但受市场波动、原材料价格上涨、新冠疫情等外部风险和问题影响，增长速度远远未达预期，到2025年无法达到《规划》目标值600亿元。由于部分传统产品市场需求有所下滑，虽然铜箔产业领域有较大发展，铜箔产能达到了近15万吨，但尚未形成足够的规模效应来弥补整体产业增长的缺口。同时，国际贸易规则及政策变化也给出口市场带来了不确定性，增加了铜箔-高端印制电路板产业链产品出口竞争的压力。

（二）推进优质企业增资扩产方面

规划提出“大力推动嘉元科技高性 能铜箔、超华科技高端铜箔和高端芯板、威华集团铜箔项目、博 敏电子新一代信息产业投资扩建和高端印制电路板生产技术改造 项目、志浩电子5G 通信领域线路板制造设备更新项目和提升高精密电路板生产工艺设备更新技术改造项目等重点项目建设。”其中：嘉元科技高性能铜箔、威华集团（盈华电子科技）铜箔项目已建成投产，博敏电子新一代信息产业投资扩建和高端印制电路板生产技术改造项目公司项目已部分建成投产，而超华科技高端铜箔和高端芯板、志浩电子5G 通信领域线路板制造设备更新项目和提升高精密电路板生产工艺设备更新技术改造项目因受市场下行、企业经营不善等原因影响，已停止实施。

（三）加强招商引资，形成发展新动能方面

规划提出“以新增一批对5G、新能源汽车等新兴领域具有关键作用和支撑能力的项目为导向，着力谋划引进高精度电子铜箔、高性能锂电铜箔、高端覆铜板和高频高速印制电路板、锂离子电池和终端产品等一批发展前景好、投资周期长、带动性强的重大项目，增强对产业的集聚和辐射带动力。”

至目前，嘉元时代、龙宇新材料、盈华电子材料、国峰半导体、吉芯半导体公司等项目陆续建成，至2024年底产值合计达到24.08亿元。

（四）新项目方面

经组织摸查，2025年全市铜箔-高端印制电路板重点项目有博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目、盈华电子科技年产4万吨高端电子铜箔建设项目、盈华电子科技年产1.66万吨高端电解铜箔改扩建项目、龙宇新材料玻纤布及射频高频材料生产项目、鼎泰电路年产220万㎡高端5G电路板生产项目等10个项目，项目合计投资额为160多亿元，计划在2025年底前实现部分完工投产的项目有博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目、盈华电子科技年产4万吨高端电子铜箔建设项目、盈华电子科技年产1.66万吨高端电解铜箔改扩建项目，预计新增2.89亿元左右。

二、调整目标的必要性

（一）外部环境变化

全球铜箔-高端印制电路板产业正处于深刻变革期，我市铜箔-高端印制电路板产业企业主要生产铜箔、覆铜板、印制电路板等基础产品，定价能力不强，国际贸易规则及政策在不断变化，将对我市铜箔-高端印制电路板产业企业生产成本、市场份额和销量存在较大的不确定性，部分企业对尚不明朗的形势持谨慎态度，这些外部环境的变化将给全市铜箔-高端印制电路板产业带来新的挑战，原规划目标已不能完全适应新形势的发展要求，需要进行调整以更好地应对市场变化。

（二）产业发展实际情况

从全市铜箔-高端印制电路板产业的实际发展情况来看，在执行规划过程中遇到了一些困难和问题，如：中美贸易摩擦、部分传统电路板产品市场需求下滑、超华科技和志浩电子等企业生产经营状况变差、新项目少等实际困难情况。同时为规范集群目标值，推动产业持续健康发展，有必要对规划目标进行调整，使其更加符合发展的实际状况，增强规划的可操作性和指导性。

三、产业规模目标

根据对全市铜箔-高端印制电路板规模以上企业2025年产值预计及项目摸查的实际情况，对梅州市铜箔-高端印制电路板产业总产值在原规划基础上调整为：到2025年末，规模以上铜箔-高端印制电路板产业集群产值目标由600亿元调整为251.46亿元，其中覆铜板、印制电路板、电声、家电、手机、电脑、平板等终端产品产值由500亿元调整为168.69亿元。

四、保障措施

一、持续紧抓产业转移机遇，招引铜箔-高端印制电路板企业，引导现有企业增资扩产，积极推动梅州市铜箔-高端印制电路板产业补链延链，向高端化发展。

二、继续积极争取和落实原中央苏区振兴发展、珠三角与粤东西北产业共建、广梅对口帮扶等国家、省、市对产业集群各方面的优惠支持政策。引导银行业金融机构加大对铜箔-高端印制电路板产业企业信贷支持。

三、对产业集群目标完成情况进行动态评测，落实“千名干部挂千企”和“一起益企”服务机制，服务重点项目建设和企业发展中的困难问题，力促铜箔-高端印制电路板产业集群规模以上产值达到发展目标。

五、结论

通过对市铜箔-高端印制电路板产业集群规划执行情况的评估，我们认识到产业发展中存在的问题和不足。根据外部环境变化和产业发展实际情况，对规划目标进行调整是必要且紧迫的。调整后的目标更加科学合理、切实可行，通过实施相应的保障措施，有望推动铜箔-高端印制电路板产业在2025年末完成规划目标。

 梅州市工业和信息化局

 2025年4月25日